

Intel: Broadwell e Skylake slittano al 2015

- Ultima modifica: Mercoledì, 03 Luglio 2013 17:24

Pubblicato: Mercoledì, 03 Luglio 2013 16:55

Scritto da Alessandro Crea



Sono emersi in queste ore alcuni interessanti dettagli sui futuri progetti Intel. A metà del 2014, Intel dovrebbe aggiornare la piattaforma attuale con gli Haswell-E, che introdurranno soluzioni a 6 e 8 core e supporto alle DDR4. Broadwell invece dovrebbe slittare al 2015, mentre Skylake arriverà nella seconda metà dello stesso anno, con altre novità.

Alcuni screenshot hanno mostrato i progetti di Intel per i prossimi due anni o almeno quelli che al momento sono i progetti in cantiere. La prima novità da registrare è lo slittamento in avanti di Broadwell, il die shrink a 14 nm dell'attuale architettura, inizialmente atteso per il 2014 ed ora previsto invece per la prima metà del 2015. **Broadwell** dovrebbe consentire anche il passaggio a un'organizzazione interna di tipo System on a Chip, con l'integrazione del PCH all'interno del die. Una soluzione già implementata negli attuali Haswell ma solo nei modelli dual core per il segmento mobile.

Haswell Platform	Attribute	Skylake Platform
Lynx Point/Wildcat Point PCH		Skylake PCH
Flip Chip Ball Grid Array	Package Type	Flip Chip Ball Grid Array
23 x 22	Package Dimension (mm x mm)	23 x 23
0.65	Minimum Ball Pitch (mm)	0.5
1.5	Max Z-Height (post SMT, 4 sigma) (mm)	<1.5
4-6L Type 3	PCB	4-6L Type 3
10 x 13.5 oval	PCB BGA Pad Size (mils)	6 x 10 oval

Prima di Broadwell dunque arriverà un sostanzioso **refresh** dei processori attuali, che dovrebbero portare diverse novità sostanziali. Dovrebbero fare la loro comparsa soluzioni a 6 core e a 8 core anche se visti i TDP previsti, compresi tra i 130 e i 140 W, si tratterà solo di modelli desktop. La cache L3 inoltre dovrebbe crescere fino a **20 MB**. A questi **Haswell-E** si accompagnerà anche la famiglia di chipset **Wellsburg**, che dovrebbe integrare il supporto alle RAM DDR4, anche a basso consumo, con clock rate fino a 2133 MHz in configurazione dual e quad channel, e anche a basso consumo (1,2 volt). Ci potranno essere poi fino a 6 porte USB 3.0, fino a otto porte USB 2.0 e fino a 10 porte SATA 6 Gbps.

Infine nella seconda metà del 2015 dovrebbe arrivare **Skylake**, che manterrà il processo

Intel: Broadwell e Skylake slittano al 2015

- Ultima modifica: Mercoledì, 03 Luglio 2013 17:24

Pubblicato: Mercoledì, 03 Luglio 2013 16:55

Scritto da Alessandro Crea

produttivo a 14 nm di Broadwell ma introducendo **un'architettura completamente nuova** e affiancherà alle novità già viste per Haswell-E anche il nuovo set di istruzioni AVX 3.2 e il supporto per lo standard PCI Express 4.0, che dovrebbe raddoppiare la banda passante della versione attuale, e SATA Express, che dovrebbe avere una bandwidth compresa tra i 10 e i 16 GB al secondo.

Via: [VR-Zone](#)